



2023年4月18日

各位

上場会社名 メック株式会社
代表者 代表取締役社長 前田 和夫
 (コード番号 4971 東証プライム市場)
問合せ先責任者 コーポレートコミュニケーション課 松下 綾
 (TEL 06-6401-8160)

北九州市との企業立地協定締結および総投資額の変更に関するお知らせ

当社は、本日、福岡県北九州市役所におきまして、福岡県北九州市（以下「北九州市」との企業立地協定を締結いたしました。なお、本件は「新たな国内拠点設置の検討に関するお知らせ」（2022年2月14日公表）、「固定資産取得に関するお知らせ」（2023年3月17日公表）に係る開示事項の経過であります。

記

1. 企業立地協定締結の目的

当社は、電子基板・部品製造用薬品の開発、製造販売を主な事業とし、特に半導体を搭載する有機パッケージ基板（以下「パッケージ基板」）の銅表面処理剤は世界中のパッケージ基板メーカーに採用されています。デジタル社会の進展による今後の電子基板・部品業界の拡大を踏まえ、特に当社と関連の深いパッケージ基板のさらなる需要増加を想定し、関連する当社製品の安定供給を目的に、福岡県および北九州市の支援をいただきながら事業展開を円滑に進めるため、企業立地協定を締結いたしました。

2. 事業計画の概要

(1) 名	称	メック株式会社 北九州工場（仮称）
(2) 所	在 地	福岡県北九州市若松区向洋町10番
(3) 敷	地 面 積	29,889㎡
(4) 着	工 時 期	2023年10月（予定）
(5) 総	投 資 額	約40億円（土地取得費含む）
(6) 投	資 計 画	自己資金および負債調達による充当（予定）
(7) 生	産 能 力	約30,000t/年（予定）
(8) 新	規雇用従業員数	10~20名（予定）
(9) 稼	働開始時期	2025年1月（予定）

総投資額について、将来的な事業拡張を見越した敷地面積の確保や収益性向上のための投資、BCP対応能力の強化、環境対応等を見込んだ結果、2022年2月14日付開示内容から変更いたしました。

3. 今後の見通し

本計画が当期（2023年12月期）の業績に与える影響は軽微であります。なお、今後開示が必要な情報が発生した場合は速やかに開示いたします。

(完成イメージ図)



以 上